

整理番号 EP-0278301

発送番号 098677

発送日 平成15年 3月25日

1 / 3

拒絶理由通知書



特許出願の番号	特願2001-015671
起案日	平成15年 3月19日
特許庁審査官	早川 朋一 9733 4L00
特許出願人代理人	井上 一 (外 2名) 様
適用条文	第29条第1項、第29条第2項、第36条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
2. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
3. この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項1, 2, 5~9
- ・理由1または2
- ・引用文献等1, 2
- ・備考

引用文献1の第1の実施形態を参照のこと。

また、引用文献2の実施例2, 3を参照のこと。

- ・請求項 3, 4, 10, 11
- ・理由 2
- ・引用文献等 1～4
- ・備考

パッド層を２層とすること、及び、パッド層を下層の配線層よりも厚く形成することは、例えば引用文献３（第４図参照）、引用文献４（図２１参照）に記載されているように周知技術である。

よって、上記引用文献1、あるいは引用文献2に記載された発明において、上記周知技術を適用することは、当業者が適宜なし得ることである。

また、この構成とすることの格別の効果は認められない。

- ・理由3

請求項 7 には、「同一層に複数の配線層をさらに有し」と記載されているが、「同一層に複数の配線層を有する」とは意味が不明であり、「さらに有する」の意味も不明である。また、どの実施例に対応するのも不明である。

よって、請求項 7 に係る発明は明確でない。

引用文献等一覽

1. 特開平 1 1 - 1 8 6 3 2 0 号公報 引例手配済
2. 特開平 0 8 - 2 1 3 4 2 2 号公報 引例手配済
3. 特開昭 6 4 - 0 8 1 2 3 6 号公報 引例手配済
4. 特開平 1 1 - 1 4 5 2 8 8 号公報 引例手配済

先行技術文献調査結果の記録

- ・調査した分野
- | | | |
|----------|---------|---------------|
| I P C第7版 | H 0 1 L | 2 1 / 3 2 0 5 |
| | H 0 1 L | 2 1 / 3 2 1 3 |
| | H 0 1 L | 2 1 / 7 . 6 8 |
| | H 0 1 L | 2 1 / 6 0 |

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ、または面接のご希望がございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第三部 半導体集積回路 審査官 早川 朋一

1
発送番号 098677

発送日 平成15年 3月25日 3 / 3

TEL. 03(3581)1101 内線3496～3498 FAX. 03(3501)0673